



高功率刀口型光束质量分析仪



产品描述

随着光纤激光技术的快速发展，千瓦级输出功率与高光束质量已成为激光切割、焊接、剥离及金属增材制造等应用的常规需求。我们的高功率测量仪器能够在光强超过每平方厘米兆瓦量级的严苛条件下测量光束特性。

产品特点

集所有 ISO 标准精确度于一体；专为大功率测量设计，功率高达 4kWatt；灵活便捷，配备可拆卸测量头，适用于常规激光光束分析；可互换式滤光片；旋转调节中心与输入透镜中心精确对齐

应用领域

工业激光加工 | 激光器与激光系统制造 | 光束传输与调试 | 科研与特殊应用

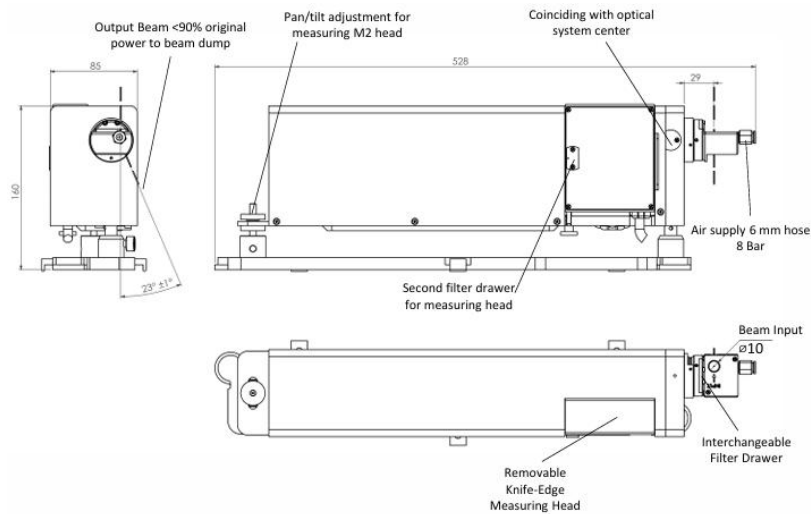
核心参数

光谱范围

220 – 1550（配备可互换测量头） 硅探头范围：350-1100



尺寸图



详细参数

参数：

参数项	数值/说明
技术原理	内置双反射采样头的测量仪器，USB 系统集成
光谱范围 (nm)	220 - 1550 (配备可互换测量头) 硅探头范围：350-1100
光束功率范围	4 kW
光束尺寸	8 mm，绝对最大值 10 mm
最小可探测发散角	优于 0.1 mRad
精度	M ² 值及常规参数精度：±5%
典型测量时间	10 秒 (若测量后冷却两分钟，效果更佳)
冷却条件	过滤加压空气，压力 6-8 Bar

参数项	数值/说明
测量方法	主光束经采样后导入刀口式测量头
光束终止装置	由用户提供
调节方式	内置水平/俯仰调节机构
材质结构	铝合金
透镜焦距	300 mm (@ 632.6 nm)
透镜直径	25 mm
扫描步数	140
最小步进尺寸	100 μ m
扫描长度	280 mm
重量	2.5 kg
外形尺寸 (宽 x 高 x 深)	85 x 160 x 530 mm
安装方式	M6 或 1/4 英寸螺丝固定
机械调节角度	水平角度: $\pm 1.5^\circ$ 垂直角度: $\pm 1.5^\circ$
电缆长度	2.5 m

应用程序兼容 Windows 7/8/10 操作系统 (32 位和 64 位)。为满足定制化集成需求, 我们提供标准的软件开发工具包 (SDK) 软件。

订购信息

MP-M2Beam-Si-HP: 适用于 Si 光谱范围 (350 – 1100nm) 的测量设备

MP-M2Beam-UV-HP: 适用于 Si 光谱范围 (190 – 1100nm) 的测量设备

MP-M2Beam-IR-HP: 适用于 InGaAs 光谱范围 (800 – 1800nm) *

***注: 红外型号可选配传感器规格 – InGaAs 传感器直径: 3mm、5mm、10mm**